

2021年度 先端電子デバイス接着技術研究会 開催予定

	日程	講演内容	講演者
第1回	7/5	エレクトロニクス機器のための接着	・九州大学・田中教授 ・三井金属鉱業（株）・森様
第2回	8/30	先端パッケージ材料開発と表面処理効果	・横浜国立大学・高橋先生 ・ナミックス（株）・水村様 ・APC（株）・與倉様
第3回	11/18	半導体パッケージの接着剤課題（仮）	・AGC（株）：細田様 ・九州大学・小椎尾先生 ・ ・
第4回	2/4	(TBD)	・ ・ ・ ・

注：予定は変更になる場合があります、ご了承くださいませ

連絡先：06-6879-4294, e-mail:f3d@sanken.osaka-u.ac.jp